



(주)진우테크

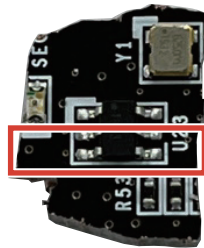
시편 전처리 센터

전자재료 (Gull Wing Leads) 시편 전처리

목적: 단면 관찰

주요 기술

절단과 연마 진행 후 결과 비교



Gull Wing Leads

샘플 이미지 (PCB)

1. 샘플 채취 (Cutting)



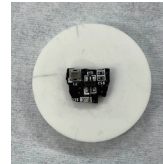
세라믹플레이트

Mounting Wax

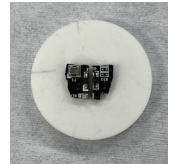
* 절단하기 전 Mounting Wax를 이용하여 세라믹 플레이트 위에 샘플을 부착



WELL 3500 Premium



절단 전



절단 후

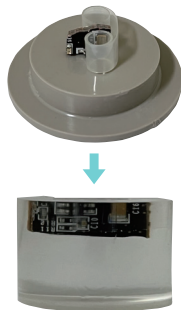
* Target을 관찰해야 하는 샘플의 경우, 정밀하게 절단 위치를 조절할 수 있는 장비 선택 필요.

2. Cold Mounting



Sample Holding Clip

* 샘플 고정을 위해 클립 사용



EpoxySet Resin/Hardener



VacuPrep

* Target이 있는 샘플의 경우 높은 투명도로 몰드 내부 확인이 용이한 EpoxySet 제품 추천.



(주)진우테크

시편 전처리 센터

전자재료 (Gull Wing Leads) 시편 전처리

3. Grinding/Polishing Auto Polisher

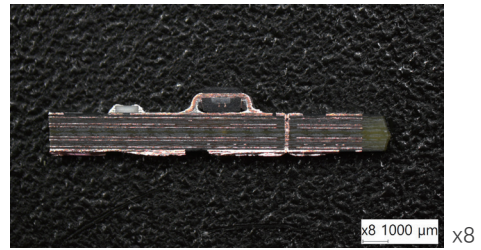
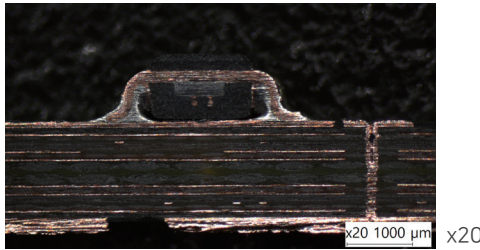


DualPrep3 PH 4 + AD 5

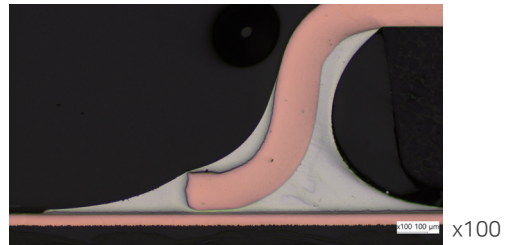
Step	Grinding				Polishing	
	1	2	3	4	5	6
Abrasive	320Grit (P-400)	600Grit (P-1200)	800Grit (P-2400)	1200Grit (P-4000)	3 μm	0.05 μm
Type	SiC	SiC	SiC	SiC	Diamond	FinalPrep Alumina
Carrier	Abrasive Disc	Abrasive Disc	Abrasive Disc	Abrasive Disc	Suspension	Solution
Polishing Cloth	-	-	-	-	DiaMat	Final A
Coolant	Water	Water	Water	Water	GreenLube	-
Platen Speed(RPM) / Direction	100 /Comp	100 /Comp	100 /Comp	100 /Comp	100 /Contra	100 /Contra
Sample Speed (RPM)	90	90	90	90	90	90
Force (lbF)	3	3	4	4	3	3
Time (min)	Until Flat	Until Target	2'00"	2'30"	2'00"	1'30"

4. 분석 결과

절단 후



연마 후



- 분석 목적에 따라 필요한 전처리 과정을 선택하여 진행 가능합니다.
- 저배율에서 샘플의 전체적인 형상 관찰을 위해 전처리를 진행하는 경우, 정밀 절단을 통해 보고자 하는 Target 을 채취하여 단면 이미지 관찰이 가능하며 고배율에서 샘플의 특정 위치를 관찰하고자 하는 경우 시각 연마 과정 후 단면을 통해 원하는 Target 을 관찰할 수 있습니다

상세 기술자료, 소모품 샘플 및 기술 상담이 필요하시면,
(주)진우테크 시편전처리 센터로 연락 주시길 바랍니다.

email : info@chinwoo.co.kr
전화 : 031-777-1277

